

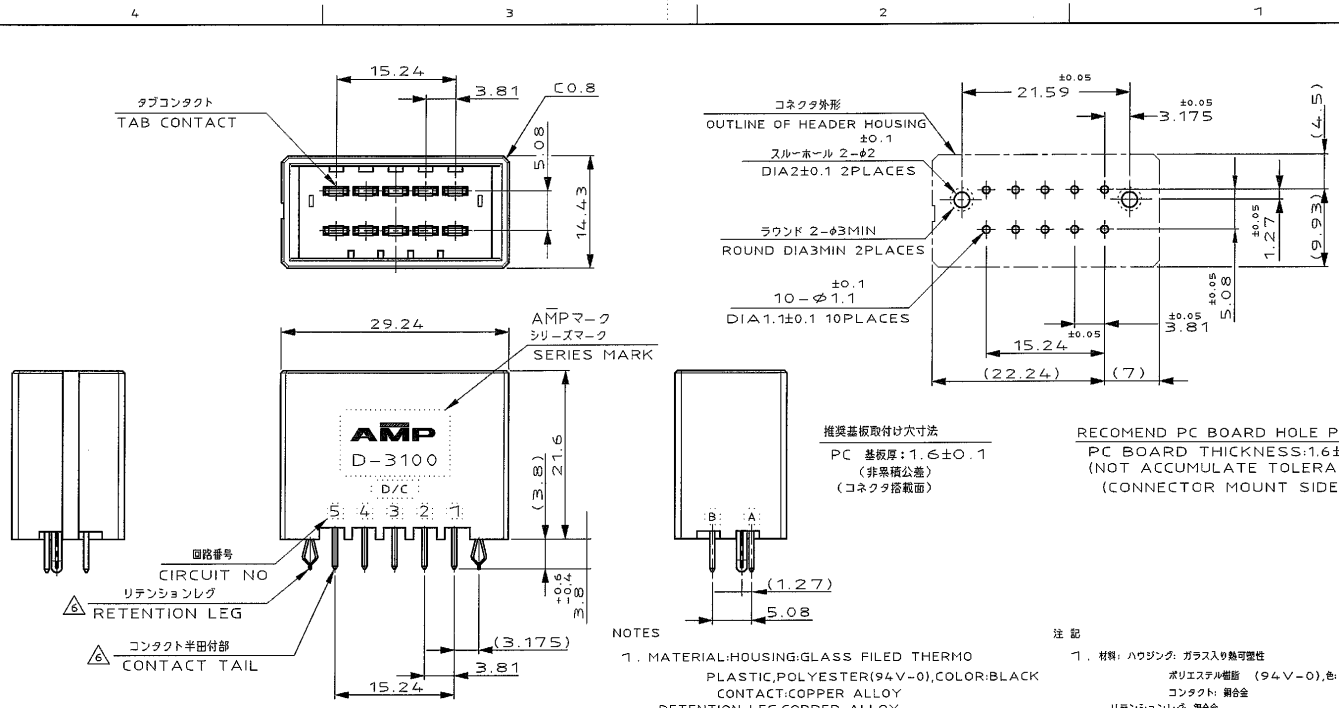
NUMBER 178325



METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST.



推奨基板取付け寸法  
PC 基板厚: 1.6±0.1 (非累積公差)  
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN  
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1 (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)  
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

- NOTES
- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK  
CONTACT: COPPER ALLOY  
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
  - FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
  - FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
  - FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
  - FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
  - FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- 注記
- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエチレン樹脂 (94V-0), 色: 黒  
コンタクト: 銅合金  
リテンションレグ: 銅合金
  - めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
めっき: 0.38 μm MIN金めっき
  - めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
めっき: 0.76 μm MIN金めっき
  - めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
めっき: 2.0 μm MINスズめっき
  - めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
めっき: ニッケル下地の上げ半田めっき
  - めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の上げスズめっき

△	△	178325-5
△	△	178325-3
△	△	178325-2
(FINISH)		部品番号 (PART NO.)

				Copyright © 1994 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
E	REVISED	FJDO-0659-03	TSSM	6/2/93	WIRE RANGE	INSULATION DIA	NAME
D	REVISED	FJDO-0097-03	TSSM	4/18/03	mmTAWG	mmD	10 POS DOUBLE ROW VERTICAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3100
C	REVISED	FJDO-2744-05	KIYI	6/16/95	MATERIAL	FINISH	(GENERAL TOLERANCE)
B	REVISED	FJDO-0838-94	NM S.M	7/4/94	注記参照	注記参照	SIZE LOC NUMBER
A	REDRAWN WITH CHANGE	FJDO-0480-94	NM S.M	4/20/94	DR. N. Matsubara 20 APR 94	DE. N. Matsubara 20 APR 94	A3 J
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE	CHK. S. MAMABE	APP. S. MAMABE	SCALE
							2-1
							REV. E
							SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面